

Obsah

1. Základní metody	3
2. Základní parametry struktur.....	5
3. Mikrodrátek	7
4. Nástroje	8
5. Vstupní protokol	9
6. Layout rozvržení plošek určených ke kontaktování k další struktuře.....	10
7. Tvarování smyčky neboli „Loop shaping“	11
8. Zařízení pro Wirebonding	12